# 製品仕様書 Specification of Piezoelectric Sounder

決定年月日 Issue Date : May 21, 2021

### 1. 品番 Part Number

	当社品番
	Murata Part Number
テーピング品 Taping	PKLCS1212E40A1-R1

## 2. 適用 Scope

当製品仕様書は、車載用の確認音等の発生回路に使用する圧電サウンダについて規定します。この用途以外にご使用の場合には事前に当社へご連絡ください。

This product specification is applied to the piezoelectric sounder used for sounder in alarm systems for automotive application. Please contact us when using this product for any other applications than described in the above.

3. 外観 及び 寸法 Appearance and Dimensions

3-1 外観	: 目視によって表示識別可能であり、汚れ等がありません。
Appearance	: No illegible marking. No visible dirt.
3-2 圧電サウンダの外形寸法図	: 製品単体の形状を項目9に示します。
Dimensions of component	: Please refer to item 9 for component dimensions.

#### 4. 最大定格 Maximum Rating

$\square$	項目Item	規 格 Specification
4-1	許容入力電圧	+12 5\/a n门下/max
	Maximum Input Voltage	±12.5Vo-p以下/max.
4-2	動作温度範囲	<b>-40</b> ∼ <b>+</b> 85°C
	Operating Temperature Range	-40 to +85°C
4-3	保存温度範囲	<b>-40</b> ∼ <b>+</b> 85°C
	Storage Temperature Range	- 40 to +85°C

# 5. 電気的性能 Electrical Characteristics

	項 目 Item	規格 Specification		
5-1 音圧レベル		75dB以上/min.		
	Sound Pressure Level			
測定条件は次項を参照して下さい。				
Refer to next item for measuring method.				



7.	機械	的性能 Physical C	haracteristics	
		試験項目	試 験 条 件	試験後の規格
		Item	Test Condition	Specification
	7-1	耐衝擊性 Shock	加速度 980m/s <sup>2</sup> 、半波正弦波の衝撃を XYZ の 3 方向に各 3 回印加後、測定します。 Components shall be measured after being applied shock(980m/s <sup>2</sup> ) for each three mutually perpendicular directions to each of 3 times by half sine wave.	
	7-2	耐振動性 Vibration Resistant	振動周波数 10~55Hz, 全振幅 1.5mm の振動 を XYZ の 3 方向に各 2 時間印加後、測定しま す。 Applying the vibration of amplitude 1.5mm and vibration frequency 10 to 55 Hz in each of 3 perpendicular directions for 2 hours.	
	7-3	基板たわみ強度 Bend Strength PCB	下図に示す様に加圧し、1回1秒の割合で5回 加圧する。 After components soldered on PCB, the load shall be applied to the PCB as shown in below figure for 5 times (1 second per 1 time).	第 1 表を満足しま す。

(2)コテ付方式       温度+350±5°Cで3.0±0.5秒間当て、常温に1時間放置後に測定する。但し、はんだこて先は電極部に直接接触しない事とする。       The measured value shall meet Table 1.         (2)コテ付方式       温度+350±5°Cで3.0±0.5秒間当て、常温に1時間放置後に測定する。但し、はんだこて先は電極部に直接接触しない事とする。       The measured value shall meet Table 1.         Soldering       Components shall be measured after soldered at +350±5°C for 3.0±0.5 seconds, and then being placed in natural condition for 1 hour. The soldering iron shall not touch the components while soldering.       Fitaんだ付性         7-5       はんだ付性       LFはんだ (Sn-3Ag-0.5Cu)       #子の90%以上にはんだが付着します。         PCT装置にて温度+105°C、湿度100%R.H.飽和の条件で、4時間のエージングをした後、端子部分をロジンメタノール液に5秒浸した後、       #子の90%以上にはんだが付着します。         Solderability       LF Solder (Sn-3Ag-0.5Cu)       The solder shall coat at least 90% of the surface of terminal.         Solderability       LF Solder (Sn-3Ag-0.5Cu)       After being kept in pressure cooker at +105°C temperature and 100%R.H. for 4 hours, terminal.       The solder shall coat at least 90% of the surface of terminal.         dering bath at temperature of +245±5°C for 3±0.5 seconds after being placed in a rosin-       # end for a formal content of the surface of terminal.		Soldering Heat (1)リフロー方式 Re-flow Soldering	て、常温に取り出し1時間後測定する。 Components shall be measured after applying twice of the re-flow soldering with following temperature profile and leaving in natural condition for 1 hour. () 260 end (20°C 以下 / max) Heating 100 明 100 (150-18°C) 第 1 表を満足し す。	æ
<ul> <li>Fill放置後に測定する。但し、はんだこて先は 電極部に直接接触しない事とする。</li> <li>Soldering with Iron</li> <li>Components shall be measured after soldered at +350±5°C for 3.0±0.5 seconds, and then being placed in natural condition for 1 hour. The soldering iron shall not touch the components while soldering.</li> <li>7-5 はんだ付性</li> <li>LFはんだ (Sn-3Ag-0.5Cu) PCT装置にて温度+105°C、湿度100%R.H.飽和 の条件で、4時間のエージングをした後、端子 部分をロジンメタノール液に5秒浸した後、 +245±5°Cの溶融はんだ中に3±0.5秒間浸す。</li> <li>Solderability</li> <li>LF Solder (Sn-3Ag-0.5Cu) After being kept in pressure cooker at +105°C temperature and 100%R.H. for 4 hours, termi- nals of components shall be immersed in a sol- dering bath at temperature of +245±5°C for 3±0.5 seconds after being placed in a rosin-</li> </ul>	-		← →   ← →   ← →   ← →   ← →   ← →   ← →   ← →   ← →   → →   → →   → → → →	
Soldering with IronComponents shall be measured after soldered at +350±5°C for 3.0±0.5 seconds, and then being placed in natural condition for 1 hour. The soldering iron shall not touch the components while soldering.7-5はんだ付性LFはんだ (Sn-3Ag-0.5Cu) PCT装置にて温度+105°C、湿度100%R.H.飽和 の条件で、4時間のエージングをした後、端子 部分をロジンメタノール液に5秒浸した後、 +245±5°Cの溶融はんだ中に3±0.5秒間浸す。端子の90%以上にいんだが付着します。 んだが付着します。 The solder shall coat at least 90% of the surface of nals of components shall be immersed in a sol- dering bath at temperature of +245±5°C for 3±0.5 seconds after being placed in a rosin-		(2)コテ付方式	時間放置後に測定する。但し、はんだこて先は	
with Ironat +350±5°C for 3.0±0.5 seconds, and then being placed in natural condition for 1 hour. The soldering iron shall not touch the components while soldering.7-5はんだ付性LFはんだ (Sn-3Ag-0.5Cu) PCT装置にて温度+105°C、湿度100%R.H.飽和 の条件で、4時間のエージングをした後、端子 部分をロジンメタノール液に5秒浸した後、 +245±5°Cの溶融はんだ中に3±0.5秒間浸す。 LF Solder (Sn-3Ag-0.5Cu) After being kept in pressure cooker at +105°C temperature and 100%R.H. for 4 hours, termi- nals of components shall be immersed in a sol- dering bath at temperature of +245±5°C for 3±0.5 seconds after being placed in a rosin-		Soldering		
being placed in natural condition for 1 hour. The soldering iron shall not touch the components while soldering.7-5はんだ付性LFはんだ (Sn-3Ag-0.5Cu) PCT装置にて温度+105°C、湿度100%R.H.飽和 		•		
Soldering iron shall not touch the components while soldering.7-5はんだ付性LFはんだ (Sn-3Ag-0.5Cu) PCT装置にて温度+105°C、湿度100%R.H.飽和 の条件で、4時間のエージングをした後、端子 部分をロジンメタノール液に5秒浸した後、 +245±5°Cの溶融はんだ中に3±0.5秒間浸す。 LF Solder (Sn-3Ag-0.5Cu)端子の90%以上に んだが付着します。 The solder shall coat at least 90% of the surface of terminal.SolderabilityLF Solder (Sn-3Ag-0.5Cu) After being kept in pressure cooker at +105°C nals of components shall be immersed in a sol- dering bath at temperature of +245±5°C for 3±0.5 seconds after being placed in a rosin-		with non		
while soldering.7-5はんだ付性Fはんだ (Sn-3Ag-0.5Cu)PCT装置にて温度+105°C、湿度100%R.H.飽和 の条件で、4時間のエージングをした後、端子 部分をロジンメタノール液に5秒浸した後、 +245±5°Cの溶融はんだ中に3±0.5秒間浸す。SolderabilityLF Solder (Sn-3Ag-0.5Cu)After being kept in pressure cooker at +105°C temperature and 100%R.H. for 4 hours, termi- nals of components shall be immersed in a sol- dering bath at temperature of +245±5°C for 3±0.5 seconds after being placed in a rosin-				
<ul> <li>7-5 はんだ付性</li> <li>LFはんだ (Sn-3Ag-0.5Cu) PCT装置にて温度+105°C、湿度100%R.H.飽和 の条件で、4時間のエージングをした後、端子 部分をロジンメタノール液に5秒浸した後、 +245±5°Cの溶融はんだ中に3±0.5秒間浸す。</li> <li>Solderability</li> <li>LF Solder (Sn-3Ag-0.5Cu) After being kept in pressure cooker at +105°C temperature and 100%R.H. for 4 hours, termi- nals of components shall be immersed in a sol- dering bath at temperature of +245±5°C for 3±0.5 seconds after being placed in a rosin-</li> </ul>				
の条件で、4時間のエージングをした後、端子 部分をロジンメタノール液に5秒浸した後、 +245±5°Cの溶融はんだ中に3±0.5秒間浸す。 LF Solder (Sn-3Ag-0.5Cu) After being kept in pressure cooker at +105°C temperature and 100%R.H. for 4 hours, termi- nals of components shall be immersed in a sol- dering bath at temperature of +245±5°C for 3±0.5 seconds after being placed in a rosin-	7-5	はんだ付性	LFはんだ (Sn-3Ag-0.5Cu)	
部分をロジンメタノール液に5秒浸した後、 +245±5°Cの溶融はんだ中に3±0.5秒間浸す。 LF Solder (Sn-3Ag-0.5Cu) After being kept in pressure cooker at +105°C temperature and 100%R.H. for 4 hours, termi- nals of components shall be immersed in a sol- dering bath at temperature of +245±5°C for 3±0.5 seconds after being placed in a rosin-			PCT装置にて温度+105℃、湿度100%R.H.飽和	
+245±5°Cの溶融はんだ中に3±0.5秒間浸す。 Solderability +245±5°Cの溶融はんだ中に3±0.5秒間浸す。 LF Solder (Sn-3Ag-0.5Cu) The solder shall After being kept in pressure cooker at +105°C temperature and 100%R.H. for 4 hours, termi- nals of components shall be immersed in a sol- dering bath at temperature of +245±5°C for 3±0.5 seconds after being placed in a rosin-			の条件で、4時間のエージングをした後、端子	
SolderabilityLF Solder (Sn-3Ag-0.5Cu)The solder shall coat at least 90% of the surface of nals of components shall be immersed in a sol- dering bath at temperature of +245±5°C for 3±0.5 seconds after being placed in a rosin-The solder shall coat at least 90% of the surface of terminal.			部分をロジンメタノール液に5秒浸した後、 端子の90%以上に	は
After being kept in pressure cooker at $\pm 105^{\circ}$ C coat at least 90% temperature and 100%R.H. for 4 hours, termi- of the surface of nals of components shall be immersed in a sol- dering bath at temperature of $\pm 245\pm5^{\circ}$ C for $3\pm0.5$ seconds after being placed in a rosin-			+245±5°Cの溶融はんだ中に3±0.5秒間浸す。 んだが付着します。	,
temperature and 100%R.H. for 4 hours, termi- of the surface of nals of components shall be immersed in a sol- terminal. dering bath at temperature of $+245\pm5^{\circ}$ C for $3\pm0.5$ seconds after being placed in a rosin-		Solderability		
nals of components shall be immersed in a sol- terminal. dering bath at temperature of +245±5°C for 3±0.5 seconds after being placed in a rosin-				
dering bath at temperature of $+245\pm5^{\circ}C$ for $3\pm0.5$ seconds after being placed in a rosin-				
3±0.5 seconds after being placed in a rosin-				
			•	
methanol for 5 seconds.				

	試験項目		試 験 条 件	試験後の規格
	Item	Т	est Condition	Specification
8-1	高温放置	温度+85±2℃に	500時間保持し、常温に取	
		出し4時間放置後	測定します。	
	Dry Heat Test	Components sha	Il be left in a chamber (Tem-	
	(Storage)	perature: +85±2°C	c) for 500 hours, then meas-	
		ured after leaving	g in natural condition for 4	
		hours.		
8-2	低温放置	温度-40±2℃に	500時間保持し、常温に取出	
		し4時間放置後測測	定します。	
	Cold Test		Il be left in a chamber (Tem-	
	(Storage)	•	) for 500 hours, then meas-	
		ured after leaving	g in natural condition for 4	
		hours.		
8-3	耐湿性		湿度 90~95%R.H.の恒温恒	
			保持し、常温に取り出し4時	
		間放置後測定しま		
	Humidity		Il be left in a chamber (90 to	
			0±2°C) for 500 hours, then	
			aving in natural condition for 4	
		hours.		shall meet Table 1.
8-4	熱衝撃		1槽中に 30 分間保持後 2~3	
			5℃の恒温槽中に 30 分間保持	
			イクルとし、500 サイクル行	
			4時間放置後測定する。	
	Thermal Shock		at room temperature, compo-	
			ced at temperature of -40°C.	
After 30 minutes at this temperature, components shall be within a few minutes placed a temperature of +85°C. After 30 minutes at this temperature components shall be returned to				
			onents shall be returned to -	
		40°C again.		
			cycles, components shall be	
			emperature. And components	
			l after being placed in natural	
		condition for 4 hou	1.	
		表1	Table 1.	
		項目	試験後の変化量	
		Item	Specification after test	
		音圧レベル	初期值±10dB	
Sound Pressure Level Initial Value±10dB				

株式会社 村 田 製 作 所 Murata Manufacturing Co.,Ltd.

#### Document No. JGB40-1585B





株式会社 村 田 製 作 所 Murata Manufacturing Co.,Ltd.

11.	⚠ 注意 Cautions	
	<ul> <li>11-1 用途の限定 Limitation of Applications</li> <li>当製品について、その故障や誤動作が人命または財産に危害を及ぼす恐れがある等の理由により、高信頼性が要求される以下の用途でのご使用をご検討の場合は、必ず事前に当社までご連絡下さい。</li> <li>①航空機器 ②宇宙機器 ③海底機器 ④発電所制御機器 ⑤医療機器</li> <li>⑥輸送機器(自動車、列車、船舶等) ⑦交通用信号機器 ⑧防災/防犯機器</li> <li>⑨情報処理機器 ⑩その他上記機器と同等の機器</li> </ul>	
	Please contact us before using our products for the applications listed below which require especially high reliability for the prevention of defects which might directly cause damage to the third party's life, body or property . ①Aircraft equipment ②Aerospace equipment ③Undersea equipment ④Power plant control equipment ⑤Medical equipment ⑥Transportation equipment(vehicles, trains, ships, etc.)	
	<ul> <li>⑦Traffic signal equipment</li> <li>⑧Disaster prevention / crime prevention equipment</li> <li>⑨Data-processing equipment</li> <li>⑩ Applications of similar complexity and /or with reliability requirements to the applications listed In the above.</li> </ul>	
	<ul> <li>11-2 フェールセーフ機能の付加 Fail-safe</li> <li>当製品に万が一異常や不具合が生じた場合でも、二次災害防止のために完成品に適切な</li> <li>フェールセーフ機能を必ず付加して下さい。</li> <li>Be sure to provide an appropriate fail-safe function on your product to prevent a second damage that may be caused by the abnormal function or the failure of our product.</li> </ul>	

- **12-1**本体に規格以上の衝撃が印加された場合、不具合を生じることがありますので、取扱い には十分にご注意下さい。 The component may be damaged if mechanical stress over this specification is applied.
- **12-2** 落下衝撃, 熱衝撃によりサージ電圧が発生しますので、回路設計には十分ご注意下さい。 Please pay attention to protect operating circuit from surge voltage provided by something of force such as falling, shock and temperature changing.
- **12-3**本体に直流電圧を印加された場合、不具合を生じることがありますので、回路設計には 十分注意して下さい。

Please pay attention never to be applied DC voltage to component.

12-4 IC等により駆動する際、安定鳴動及びIC保護用にIC出力端と本体に直列抵抗約1k~2kΩ を挿入するか、本体と並列にダイオードを挿入して、ご使用下さい。 The resistor should be used as shown in Fig. A. A suitable resistance value should be chosen, preferably 1kΩ to 2kΩ. Instead of this measure, a diode may also be applied as shown in Fig. B.



- **12-5**本体は密閉構造ではありませんので洗浄できません。 Washing of the component is not acceptable, because it is not sealed.
- **12-6** エアガン等で近距離から製品に直接高圧エアを吹き付けないで下さい。 High pressure air should not be blown on the component directly at short range by air gun or equivalent.

13.	製品保	管上の注意 Notice on Product Storage
	13-1	温度-10~+40℃、相対湿度15~85%で、急激な温湿度変化のない室内で保管下さい。 Please store the products in room where the temperature / humidity is stable. And avoid such places where there are large temperature changes. Please store the products under the following conditions : Temperature : -10 to +40 (degree C) Humidity : 15 to 85% R.H.
	13-2	製品保管期限は未開梱、未開封状態にて、納入後6ヶ月間です。納入後6ヶ月以内でご使 用下さい。6ヶ月を越える場合ははんだ付け性等をご確認の上、ご使用下さい。 Expire date (Shelf life) of the products is 6 months after delivery under the conditions of a sealed and an unopened package. Please use the products within 6 months after delivery. If you store the products for a long time (more than 6months), use carefully because the products may be degraded in the solder-ability and/or rusty. Please confirm solder-ability and characteristics for the products regularly.
	13-3	酸、アルカリ、塩、有機ガス、硫黄等の化学的雰囲気中で保管されますとはんだ付け性 の劣化不良等の原因となりますので、化学的雰囲気中での保管は避けて下さい。 Please do not store the products in a chemical atmosphere (Acids, Alkali, Bases, Organic gas, Sulfides and so on), because the characteristics may be reduced in quality, and/or be degraded in the solder-ability due to the storage in a chemical atmosphere.
	13-4	湿気、塵等の影響を避けるため、床への直置きは避けて保管下さい。 Please do not put the products directly on the floor without anything under them to avoid damp places and/or dusty places.
	13-5	直射日光、熱、振動等が加わる場所での保管は避けて下さい。 Please do not store the products in the places such as : in a damp heated place, in a place where direct sunlight comes in, in place applying vibrations.
	13-6	開梱、開封後、長期保管された場合、保管状況によっては、はんだ付け性等が劣化する 可能性があります。開梱、開封後は速やかにご使用下さい。 Please use the products immediately after the package is opened, because the characteristics may be reduced in quality, and/or be degraded in the solder-ability due to storage under the poor condition.
	13-7	製品落下により、製品内部のセラミック素子の割れ等の原因となりますので、容易に落下しない状態での保管とお取扱いをお願い致します。 Please do not drop the products to avoid cracking of ceramic element.
14.	止お服	頂い Note
	14-1	ご使用に際しましては、貴社製品に実装された状態で必ず評価して下さい。 Please make sure that your product has been evaluated in view of your specifications with our product being mounted to your product.
	14-2	当製品を当製品仕様書の記載内容を逸脱して使用しないで下さい。 You are requested not to use our product deviating from this product specification.